

2024-2030年中国半导体封装用键合丝行业发展运行现状及投资战略规划报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2024-2030年中国半导体封装用键合丝行业发展运行现状及投资战略规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/jingpin/electric/933571.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体的引线键合材料——键合丝概述

1.1 键合内引线材料

1.1.1 半导体的引线键合技术发展

1.1.2 引线键合技术（WB）

1.1.3 载带自动键合技术（TAB）

1.1.4 倒装焊技术（FC）

1.2 键合丝及其在半导体封装中的作用

1.2.1 键合丝定义及作用

1.2.2 键合丝在半导体封装中的作用

1.3 键合丝的主要品种

第二章 键合丝行业特点及应用市场的概述

2.1 世界半导体封装用键合丝行业发展概述

2.2 键合金属丝的应用领域

2.3 封装用键合丝行业的发展特点

2.3.1 键合丝是半导体封装中不可缺少的重要基础材料

2.3.2 产品与常规焊接材料有所不同

2.3.3 键合丝行业进步与半导体发展关系密不可分

2.3.4 键合丝行业内驱于更加激烈的竞争

2.3.5 产品品种多样化特点

2.3.6 键合丝应用市场的新变化

2.4 当前世界及我国键合丝行业面临的问题

2.4.1 原材料成本的提高

2.4.2 新品研发的加强

2.4.3 知识产权的问题越发突出

2.4.4 国内市场价格竞争更趋恶化

第三章 键合丝的品种、性能与制造技术

3.1 键合丝的品种及各品种的性能对比

3.2 键合丝的性能要求

3.2.1 理想的引线材料应具备的性能特点

3.2.2 对键合金丝的性能要求

3.2.3 对键合丝的表面性能要求

3.2.4 对键合丝的线径要求

3.3 键合丝的主要行业标准

3.4 键合金丝的主要品种

3.4.1 按用途及性能划分

3.4.2 按照键合要求的弧度高低划分

3.4.3 按照键合不同封装形式划分

3.4.4 按照键合丝应用的不同弧长度划分

3.5 键合金丝的生产工艺过程

3.5.1 键合金丝制备的工艺流程

3.5.2 影响金丝在键合过程中可靠性的因素

3.5.3 加入微量元素进行调节键合丝的性能

3.6 键合金丝生产用原料高纯金的制备

3.7 键合金丝未来的发展方向

第四章 世界及我国键合金丝市场现状

4.1 世界键合丝市场规模情况

4.2 世界不同类型的键合丝市场比例变化

4.3 世界键合金丝的产销量及其市场格局

4.3.1 世界键合金丝的产销量及其市场格局

4.3.2 世界键合铜丝市场的需求情况与格局变化

4.4 我国键合丝市场需求量情况

4.5 我国国内键合金丝市场需求量情况

4.5.1 我国国内键合金丝市场规模变化

4.5.2 我国国内键合金丝的市场格局

4.6 我国键合铜丝的市场需求情况

第五章 键合铜丝的特性及品种

5.1 键合铜丝产品的发展

- 5.1.1 键合铜丝将成为IC封装引线键合的主要键合丝品种
- 5.1.2 键合铜丝发展历程
- 5.1.3 制造技术进步推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变
- 5.2 键合铜丝的特性
 - 5.2.1 键合铜丝与其它键合丝主要性能对比
 - 5.2.2 键合铜丝的成本优势
 - 5.2.3 键合铜丝的性能优势
- 5.3 国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能
 - 5.3.1 国外键合铜丝产品发展概述
 - 5.3.2 田中贵金属集团的产品
 - 5.3.3 新日铁公司的覆PD键合铜丝
 - 5.3.4 贺利氏公司的键合铜丝产品
 - 5.3.5 MKE电子公司的键合铜丝产品
- 5.4 我国半导体键合用铜丝标准介绍
 - 5.4.1 标准编制的经过
 - 5.4.2 标准中主要技术指标

第六章 键合铜丝的制造工艺过程及其产品知识产权情况

- 6.1 键合铜丝的制造工艺流程简述
- 6.2 键合铜丝制造的具体工艺环节
 - 6.2.1 坯料铸造
 - 6.2.2 成丝加工
 - 6.2.3 热处理
 - 6.2.4 复绕（卷线）
- 6.3 键合铜丝制造过程中的质量影响因素
 - 6.3.1 工艺过程控制对键合铜丝的质量影响
 - 6.3.2 键合铜丝的组织与微结构对其质量影响
- 6.4 镀钯键合铜丝的特性及其生产工艺过程
 - 6.4.1 研发、生产镀钯键合铜丝的重要意义
 - 6.4.2 镀钯键合铜丝的工艺流程
 - 6.4.3 镀钯键合铜丝的工艺特点
- 6.5 键合铜丝知识产权情况
 - 6.5.1 世界及我国键合铜丝专利情况
 - 6.5.2 新日铁公司实施专利战略的情况

第七章 键合金丝、键合铜丝的三大应用市场领域现况与发展预测

7.1 键合丝应用市场之一——半导体封测市场现况与发展

7.1.1 世界半导体封测产业概况及市场

7.1.2 我国半导体封测产业现况及发展

7.1.2.1 国内IC封装测试业生产现况

7.1.2.2 国内IC封测厂商的分布及产能

7.1.2.3 国内IC封装测试业销售收入前10家企业情况

7.1.2.4 国内IC封装测试业在技术上进步

7.1.3 国内IC封装测试业的发展趋势与展望

7.2 键合丝应用市场之二——我国分立器件及其封测产业的生产概况及市场

7.2.1 我国分立器件市场现况

7.2.2 国内分立器件生产企业情况

7.2.3 国内分立器件产业发展前景展望

7.3 键合丝应用市场之三——我国LED封装产业的生产概况及市场

7.3.1 键合丝在LED封装中的应用

7.3.1.1 键合丝在LED封装制造中的功效

7.3.1.2 焊线压焊的工艺流程

7.3.2 我国LED封装产业现况

7.3.3 我国LED封装企业分布情况

7.3.4 我国LED封装产业规模情况

7.3.5 我国LED封装产业未来几年发展的预测与分析

第八章 世界键合丝生产现况及其主要生产企业现况

8.1 世界键合丝产业的变化与现况

8.2 世界键合丝主要生产厂家概述与现况分析

8.2.1 世界键合丝的主要生产厂家概述

8.2.2 近年世界各国/地区键合金丝生产企业的变化分析

8.2.2.1 日本键合丝生产企业

8.2.2.2 欧美企业贺利氏集团

8.2.2.3 韩国键合丝生产企业

8.3 世界键合丝的主要生产厂家及其产品情况

8.3.1 田中贵金属株式会社

8.3.2 贺利氏集团

第九章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况

9.1 国内键合丝产业发展概述

9.1.1 国内键合丝行业总况

9.1.2 国内键合丝生产企业的现况

9.1.3 国内键合丝生产企业地区分布情况

9.2 国内键合铜丝行业的生产情况

9.2.1 国内键合铜丝生产发展概述

9.3 国内键合丝的主要生产厂家及其产品情况

9.3.1 贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司

9.3.2 宁波康强

9.3.3 北京达博

9.3.4 烟台招金励福

9.3.5 昆明贵研铂业

9.3.6 铭凯益电子（昆山）股份有限公司

9.3.7 中钞长城贵金属有限公司

9.3.8 贺利氏招远贵金属材料有限公司

9.3.9 田中电子（杭州）有限公司

9.3.10 烟台一诺电子材料有限公司

9.3.11 四川威纳尔特种电子材料有限公司

9.4 国内其它新建、在建的键合丝生产厂家情况

9.4.1 广东佳博电子科技有限公司

9.4.2 合肥矽格玛应用材料有限公司

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/jingpin/electric/933571.html>